

2019 年 11 月 18 日

第 3 回接着・接合研究シンポジウムのご案内

拝啓

歳末ご多端の折 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

当コンソーシアムにおいて例年開催しております接着・接合研究シンポジウムに関しまして、本年度も下記の通り、第 3 回接着・接合研究シンポジウムを開催させていただきます。

今回の海外招待講演者として、接着接合部の強度評価の第一人者である Imperial College London : Bamber Blackman 氏、非破壊検査の重鎮である Fraunhofer-Institute for Nondestructive Testing IZFP : Bernd Valeske 氏をお招きし、ご講演頂きます。また、国内招待講演者として、株式会社デンソー：青木 孝司 氏より、車載品等の接着技術に関してご講演頂きます。

年末のお忙しいところ、ご面倒をお掛け致しますが、奮ってご参加いただけましたら幸いです。

敬具

記

第 3 回接着・接合研究シンポジウム

－接着の適用技術とその展開－

日時：令和元年 12 月 2 日（月）10:00～17:00

場所：ベルサール神田

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町 7 住友不動産神田ビル 2・3F

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/tokyo/bs_kanda/access/

プログラム：

10:00-10:05 開会の挨拶

10:05-11:05 招待講演 1 : Fracture mechanics characterisation of structural adhesive joints:

Achievements and future challenges

Dr B R K Blackman

Reader in the Mechanics of Materials, Department of Mechanical Engineering,
Imperial College London, United Kingdom

11:05-12:05 招待講演 2 : Cognitive Sensor Systems and Next Generation NDT:

New potentials and approaches for evaluation of smart materials data
- Application Scenarios for lightweight constructions and joints

Prof. Dr.-Ing. Bernd Valeske,

Vice Director of Fraunhofer IZFP and Head of Expert Group on
NDT4.0 (Digitalization of NDT) at the German Society for Nondestructive Testing (DGZfP)

12:05-12:30 海外招待講演者との意見交換

12:30-14:00 休憩

14:00-15:00 招待講演 3 : 自動車分野における接着接合技術の取り組み

株式会社デンソー 本社 材料技術部 次長 青木 孝司

15:00-15:30 接着・接合技術コンソーシアムのこれまでの活動概要と今後の展開

接着・接合技術コンソーシアム 副代表 田嶋 一樹

15:30-16:00 海外動向調査報告

産総研 製造技術研究部門 研究グループ長 寺崎 正

16:00-17:00 ポスターセッション